

JEITA

電子情報技術産業協会技術レポート

Technical Report of Japan Electronics and Information Technology Industries Association

EIAJ EDR-7332

**集積回路パッケージデザインガイド
デュアルテープキャリアパッケージ(タイプ1, タイプ2)**

**Design guideline of integrated circuits
for Dual Tape Carrier packages(Type1, Type2)
(DTP(1), DTP(2))**

2002年9月制定

作 成

半導体パッケージ標準化委員会

Technical Standardization Committee on Semiconductor Device Package

発 行

社団法人 電子情報技術産業協会

Japan Electronics and Information Technology Industries Association

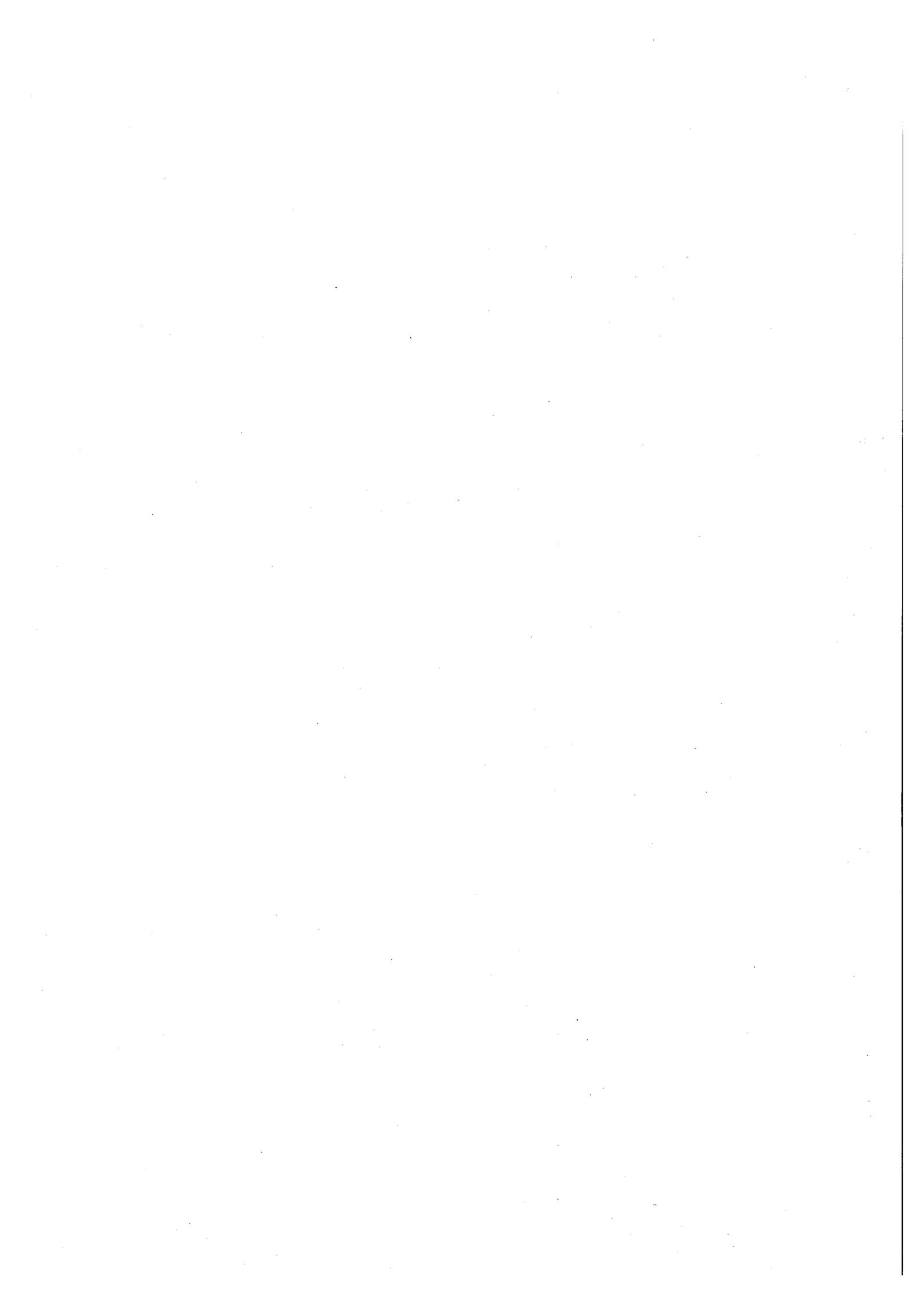
Translation without guarantee in the event of any doubt arising, the original standard in Japanese is to be evidence.

JEITA standards are established independently to any existing patents on the products, materials or processes they cover.

JEITA assumes absolutely no responsibility toward parties applying these standards or toward patent owners.

© 2002 by the Japan Electronics and Information Technology Industries Association

All rights reserved. No part of this standards may be reproduced in any form or by any means without prior permission in writing from the publisher.



Technical report of Japan Electronics and Information Technology Industries Association

Design guideline of Integrated Circuits for Dual Tape Carrier packages (Type 1, Type 2) (DTP (1), DTP (2))

1. Scope of Application

This technical report regulated outline drawings and dimensions about Dual Tape Carrier package (hereinafter referred to as DTP), which is classified as form G among the Tape Carrier package (hereinafter referred to as TCP) in **EIAJ ED-7300** [Recommended practice on Standard for the preparation of outline drawings of semiconductor packages].

Note: This technical report is the revision version to have integrated the following two standards into.

EIAJ ED-7432 (General rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits, Dual Tape Carrier packages (Type I)), established in December 1993.

EIAJ ED-7433 (General rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits, Dual Tape Carrier packages (Type II)), established in December 1993.

2. Definition of the Technical Terms

The definition of the technical terms used in this technical report is in conformity with **EIAJ ED-7300**, and as for the new term, it depends on the following.

(1) Sprocket hole

The holes arrayed at the both sides of a tape at the constant pitch which are used feed the tape. 2 kinds of Super and Wide are prescribed by the size of the sprocket hole.

(2) Outerlead

The composition of the package, which was arranged because of the electric, mechanical and thermal connection. It is defined as the terminal in **EIAJ ED-7300**.

(3) Test pad

The terminal part which was arranged outside outerlead to examine electricity.

(4) Lead pattern

The part which connects the interval of the IC and outerlead at the center and the interval of outerlead and the test pad electrically in the wiring.

(5) Outerlead hole

The hole which was opened outside the package main unit to form outerlead.

(6) Corner tie bar

The part which separates outerlead hole in the part of the insulation tape which was prepared for the 4 corners of the main unit to maintain a package main unit in the insulation tape.

電子情報技術産業協会技術レポート

集積回路パッケージデザインガイド
デュアルテープキャリアパッケージ (タイプ1, タイプ2)
Design guideline of Integrated Circuits
for Dual Tape Carrier packages (Type 1, Type 2)
(DTP (1), DTP (2))

1. 適用範囲 このデザインガイドは EIAJ ED-7300 [半導体パッケージの外形規格作成に関する基本事項] でフォーム G として区分されているテープキャリアパッケージ(以下, TCP という。)のうち, デュアルテープキャリアパッケージ(以下, DTP という。)の外形図及び寸法について規定する。

備考 この技術レポートは, 以下の 2 つの規格を統合した改正版である。

EIAJ ED-7432(集積回路外形通則 デュアルテープキャリアパッケージ(タイプ I)),

1993 年 12 月制定

EIAJ ED-7433(集積回路外形通則 デュアルテープキャリアパッケージ(タイプ II)),

1993 年 12 月制定

2. 用語の定義 この規格で用いられる用語は, EIAJ ED-7300 によるほか, 新規の用語については, 以下による。

- (1) **スプロケットホール** テープの送りに利用される孔で, テープの両端に一定のピッチで配列されたもの。スプロケットホールのサイズにより Super, Wide の 2 種類が規定されている。
- (2) **アウトリード** EIAJ ED-7300 では端子として定義されているもので, 電氣的, 機械的, 熱的な接続のために配置されたパッケージの構成部分。
- (3) **テストパッド** 電気試験のために, アウトリードの外側に配置された端子部分。
- (4) **リードパターン** 中央の IC とアウトリードとの間, 及びアウトリードとテストパッドとの間を電氣的に配線接続する部分。
- (5) **アウトリードホール** アウトリードを形成するために, パッケージ本体の外側にあけられた孔。
- (6) **コーナータイバ** 絶縁テープ内にパッケージ本体を保持するために, 本体の四隅に設けられた絶縁テープの一部で, アウトリードホールどうしを分離する部分。